

EDITORIAL

Druckte Elektronik – Hype, Megatrend, Nischen-
technologie oder sogar lange schon Stand der Technik 2281

VERBÄNDE

 **FBdi - Informationen** 2344

 **FED - Informationen** 2369

 **ZVEI: - Informationen** 2405
Die Elektroindustrie

 **MAPS - Mitteilungen** 2442
DEUTSCHLAND

 **3-D MID - Informationen** 2455

 **DVS - Mitteilungen** 2489

AKTUELLES

Nachrichten/Verschiedenes 2284

Neue Normen 2298

Tagungen/Fachmessen/Weiterbildung 2299

Productronica Vorbericht – Teil 2 2304

BAUELEMENTE

XMC-Mikrocontroller nach IEC 60730 2336

Kompakte Autoscheinwerfer-LED mit zwei Chips
erzeugt mehr Helligkeit 2339

Neue Daten- und Schaltglieder 2340

Diverse BEC- und HDMI-Verbinder 2342

DESIGN

Steca erweitert preisgekrönte Coolcept-Topologie 2346

EDA-Software-Vertrieb mit Vergangenheit und Zukunft 2349

Elegantes Design für die Unterhaltungselektronik 2351

Vybird Controller mit maßgeschneidertem
ARM Development Studio 5 2352

DESIGN

Telematik Award 2013 für mobiles Datenterminal 2354

Optimiertes SMD-Gehäuse-Design für Hochfrequenz-
Anwendungen 2355

Altium setzt mit seinem nativen 3D PCB Design
für ECAD/MCAD-Integration neue Maßstäbe 2356

Boeing 787 – modernstes Passagierflugzeug der Welt
mit vielen Zuverlässigkeitsproblemen 2357

LEITERPLATTENTECHNIK

Auf den Punkt gebracht (H.J. Friedrichkeit)
Branche unter Strom – Die Elektromobilität
nimmt Fahrt auf 2377

Der Fokus liegt auf Prozessoptimierung 2384

Produktiver fertigen mit dem Laser-Direktbelichter 2392

IPC/FED-Konferenz zu eingebetteten Komponenten 2396

Kupferfolien für Feinstleiter und IC-Packaging
sowie für Anwendungen mit eingebetteten
Komponenten und Coreless-Aufbauten 2401

BAUGRUPPEN & SYSTEME

Autonom agierender Transport-Roboter 2416

Marktanforderungen und Kundenwünsche spiegeln sich
in der neuen Druckerplattform von EKRA wider 2420

Großes Interesse an QFN- und BTC-Verarbeitung 2424

Mikromontage mit Hochpräzision 2426

„Wir gehen in die Tiefe“ – zum fünften Mal in Dresden 2430

Vielseitige Schablonenlösungen 2437

Das gesamte Materialmanagement optimiert 2438

Lötssysteme fertigen nun auch Solarmodule 2440

ANALYTIK & TEST

Neues Inspektionssystem, erweiterte SW-Plattform
und neues BS-Komplettpaket aus Jena 2445

ATE-Tag der Technologie verzeichnete über 100 Teilnehmer 2447

Neue Produkte – Viscom ist optimistisch für die Zukunft 2449

Leitwertmessgerät mit zwei Stromausgängen für Leitwert-
und Temperaturmessung 2454

Funktionstester und Prüfadapter in einem für
individuelle Testsysteme 2454

FORSCHUNG & TECHNOLOGIE

1000-mal schneller – mit Massendruckverfahren gedruckte organische Transistoren schalten heute im kHz-Bereich	2458
Gedruckte Elektronik auch ohne Reinraum	2464
Inkjet und Aerosol Jet gedruckte kapazitive Berührungs- und Feuchtesensoren auf spritzgegossenen Thermoplasten	2468
Gedruckte ferritkernbasierte Spulen am Beispiel des Sensorelementes für die Positionsmessungen	2477
Patente	2485

FORUM

Microelectronics Saxony – Neue Ausrichtung zur Stärkung im internationalen Wettbewerb	2491
Plasma-Handgerät für die Vorbehandlung in der Verbindungstechnik	2500
Kabellose Elektro-Busse erobern in Korea die Straßen	2502
Kolumne – Anders gesehen: Ein Lötfehler aus dem Wilden Westen	2503
PLUS-Firmenverzeichnis	2505
Firmenindex	2529
Stellenmarkt und Kleinanzeigen	2531
Inserentenindex	2532
Anzeigenformate und Preise	2534
Impressum	2535
Produkt des Monats	2536

Titelbild: Der EDA-Distributor FlowCAD feiert sein 10-jähriges Firmenjubiläum und bedankt sich bei allen Lesern der PLUS für das entgegengebrachte Vertrauen.

www.flowcad.de

Die Fachzeitschrift PLUS ist das Organ folgender Fachverbände:



Fachverband Bauelemente
Distribution e.V.,
Tel. +49/8165/670233,
w.ziehfuss@fbdi.de, www.fbdi.de



Fachverband Electronic
Components and Systems
Tel. +49/69/6302-276 bzw. -251,
zvei-be@zvei.org, www.zvei.org



Fachverband Elektronik-Design e.V.,
Tel. +49/30/8349059,
info@fed.de, www.fed.de



Fachverband PCB
and Electronic Systems
Tel. +49/69/6302-437,
PCB-ES@zvei.org, www.zvei.org



INTERNATIONAL
MICROELECTRONICS
AND PACKAGING SOCIETY –
Deutschland e.V.,
Tel. +49/3677/69-3381,
martin.schneider-ramelow@imaps.de
www.imaps.de



Forschungsvereinigung
Räumliche Elektronische
Baugruppen 3-D MID e.V.
Tel. +49/91 1/5302-9100,
info@3dmid.de, www.3dmid.de



European Interconnect
Technology Initiative e.V.
Tel. +49/69/6302-281,
eiti@zvei.org, www.eiti.org



DVS – Deutscher Verband
für Schweißen und
verwandte Verfahren e.V.
Tel. +49/211/1591-0,
michael.weinreich@dvs-hg.de,
www.dvs-ev.de

Die offiziellen Verbandsmitteilungen an Mitglieder und Fachwelt erscheinen monatlich in der PLUS.